



时间：2017年10月10日（周二）18:30-20:30（30-40分钟宣讲，之后笔试）

地点：中心教学楼 231 教室

芯机遇，实现芯梦想

——兆易创新 2018 校园招聘

芯团队

北京兆易创新科技股份有限公司（简称“兆易创新”，沪市股票代码 603986），成立于 2005 年 4 月，是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。

公司致力于各类存储器（SPI NOR FLASH®、SPI NAND FLASH™）、控制器（GD32™ MCU）以及 eMMC 的设计研发，研发人员比例占全员比例 60% 以上，在中国大陆（北京/合肥/西安/上海/深圳）、香港、台湾、韩国、美国、日本、英国等多个国家和地区设有分支机构，营销网络遍布全球，并与多家世界知名晶圆厂、封装测试厂结成战略合作伙伴关系，为客户提供优质便捷的本地化支持服务。

公司核心管理团队由来自世界各地的高级管理人员组成，每位都曾在硅谷、韩国等著名 IC 企业工作多年，有着丰富的研发及管理经验。公司总裁兼 CEO 朱一明先生是国家“千人计划”的入选者，被授予国家级“特聘专家”荣誉称号。他领导下的兆易创新被授予“‘中国芯’最佳市场表现奖”、“重大科技成果产业化突出贡献单位”、“创新型试点企业”、“中国十强最具成长性半导体企业”等多项荣誉称号。

公司现有员工 400 余人，85% 以上研发人员来自 211 或 985 高校。我们广纳雄心勃勃的专业人员和高级人才，提供包括年底双薪、年终绩效奖金、五险一金、补充医疗保险、商业意外保险、各类补贴、免费健康体检、带薪假期、节日礼品、新生儿礼金等有竞争力的薪资福利待遇。除此之外，公司还注重员工自身价值的提升，不遗余力组织各类培训项目，与员工共享公司成长硕果。

上市信息：沪市主板上市的第一家存储器芯片设计公司

行业地位：

- SPI NOR Flash 代码闪存领域顶尖的 Fabless 供应商；国内本领域的**龙头企业**
- **全球首家**推出 8-Pin SPI NAND Flash 闪存产品
- 中国高性能通用 MCU 领域的**领跑者**
- 中国大陆**首家**推出 ARM® Cortex®-M3/M4 内核通用 MCU 产品
- 中国串行闪存行业标准的**发起者与起草者**

全球研发中心：美国硅谷、中国北京、合肥、西安、上海

全球销售支持网络：北京、上海、深圳、合肥、西安、香港、台湾、美国、英国、韩国、日本

公司总部：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层

其他各地分支机构地址欢迎查阅公司网站 www.gigadevice.com

芯福利



欢迎关注兆易创新招聘微信号，获得最新鲜的招聘资讯！扫描二维码，或微信搜索“兆易创新招聘”。



**芯机遇！欢迎加入兆易！****北理工宣讲、笔试时间地点安排****时间：2017年10月10日（周二）18:30-20:30（30-40分钟宣讲，之后笔试）****地点：中心教学楼231教室**★ 网申地址：job.gigadevice.com（参加宣讲笔试环节请携带一份纸质简历）★ 只能投递一个职位哦~，投递简历过程中，如有任何疑问，欢迎随时联系 campusfaq@gigadevice.com，我们将尽快为您解答。

| 招聘岗位 | 人数 | 学历 | 专业 | 工作地 | 产品研发方向 |
|------------------------|----|-------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 模拟全定制电路设计工程师 | 10 | 硕士及以上 | 微电子/电子/电路等相关专业 | 北京/合肥/西安 | Flash |
| 模拟集成电路设计工程师 | 10 | 硕士及以上 | 微电子/电子/电路等相关专业 | 北京/西安 | MCU |
| 数字电路设计/验证工程师 | 20 | 硕士及以上 | 微电子/电子/电路等相关专业 | 北京/合肥/西安 /苏州 | Flash/MCU |
| IC版图设计工程师 | 14 | 本科及以上 | 微电子/电子/电路等相关专业 | 北京/合肥/西安 | Flash/MCU |
| 后端设计工程师（P&R） | 6 | 硕士及以上 | 微电子/电子/电路等相关专业 | 北京/西安 | MCU |
| 嵌入式软件/应用工程师 | 21 | 硕士及以上 | 计算机/电子工程/通信/自动化 相关专业 | 北京/西安/苏州 | MCU |
| 系统开发工程师 | 15 | 本科及以上 | 电子类相关专业 | 合肥 | MCU |
| FAE技术支持工程师 | 6 | 本科及以上 | 电子/通讯/自动化等相关专业 | 深圳/合肥 | MCU |
| IC测试工程师 | 15 | 本科及以上 | 测控/自动化/计算机/通信/微 电子等相关专业 | 合肥 | Flash/MCU |
| 器件工程师 | 3 | 硕士/博士 | 微电子等相关专业 | 北京 | Flash |
| 嵌入式软件（Firmware） 工程师 | 10 | 硕士及以上 | 计算机/电子/电路/控制理论与 工程等相关专业 | 合肥 | Date System |
| 嵌入式系统工程师 | 8 | 硕士及以上 | 计算机/电子/电路/控制理论与 工程等相关专业 | 合肥 | Date System |
| 射频集成电路设计工程师 | 9 | 硕士及以上 | 通信/微电子/微波等相关专业 | 北京/西安/苏州 | MCU |
| 产品工程师 | 5 | 本科及以上 | 电子/微电子等相关专业 | 合肥 | Flash |
| 无线网络物理层工程师 | 3 | 硕士及以上 | 通信/电子等相关专业 | 苏州 | MCU |

具体职位要求如下：

1、模拟全定制电路设计工程师（工作地：北京/合肥/西安）

岗位职责：

负责 Flash 产品和 IP 研发，负责相关电路的设计，仿真和评估

任职要求：

1. 微电子等相关专业，硕士及以上学历
2. 熟练使用 VIRTUOSO、HSPICE 等 IC 设计仿真工具
3. 有 DCDC/LDO/ADC/DAC 经验者优先
4. 对 SRAM/DRAM/FLASH/EEPROM 有了解者优先
5. 诚信正直，踏实努力，具有较强的抗压能力
6. 具有良好的沟通能力、学习能力、分析能力和团队合作能力

2、模拟集成电路设计工程师（工作地：北京/西安）

岗位职责：

负责芯片的模拟电路设计和仿真

任职要求：

1. 微电子等相关专业，硕士及以上学历
2. 熟练使用 HSPICE、HSIM 等仿真工具
3. 有 ADC/DAC/LDO/PLL 经验者优先
4. 诚信正直，踏实努力，具有较强的抗压能力
5. 具有良好的沟通能力、学习能力、分析能力和团队合作能力

3、数字电路设计/验证工程师（工作地：北京/合肥/西安/苏州）

岗位职责：

参与 Flash 产品，相关 Controller 和 IP 研发，负责逻辑设计与产品功能验证（Flash BU）；或基于 ARM 架构的高性能/低功耗 SoC 项目研发（MCU BU）

任职要求：

1. 微电子/电子相关专业，硕士及以上学历
2. 有深厚的数字专业知识，熟练掌握数字电路设计和验证方法学
3. 有实际项目经验，精通 Verilog, System Verilog, TCL, PERL 等语言
4. 熟悉低功耗设计
5. 有较强动手能力和抗压能力

6. 正直诚信、有责任心和团队合作精神

4、IC 版图设计工程师（工作地：北京/合肥/西安）

岗位职责：

负责版图设计工作

任职要求：

1. 微电子、电子工程相关专业，本科以上学历
2. 熟悉模拟版图设计，有一定的模拟电路基础
3. 熟悉 virtuoso，熟练使用 calibre 进行 DRC、LVS 检查
4. 有 PLL/ADC/DAC/BGR 等模拟模块版图设计经验优先考虑
5. 熟悉 SKILL/perl/TCL 等编程语言优先考虑
6. 有大型芯片模块整合工作经验优先考虑
7. 有 65nm 以下工艺经验优先考虑
8. 诚信正直，踏实努力，具有较强的抗压能力
9. 具有良好的沟通能力、学习能力、分析能力和团队合作能力

5、后端设计工程师（P&R）（工作地：北京/西安）

岗位职责：

负责数字后端自动布局布线工作

任职要求：

1. 微电子、电子工程相关专业，硕士以上学历
2. 熟悉数字后端自动布局布线流程
3. 有大规模数字 IC 项目经验
4. 对低功耗设计有一定的了解
5. 吃苦耐劳、有责任心和团队合作精神
6. 有标准单元建库经验优先考虑
7. 熟悉多电源域 PR 流程优先考虑
8. 有 65nm 以下工艺经验优先考虑

6、嵌入式软件/应用工程师（工作地：北京/西安/苏州）

岗位职责：

负责 32 位 MCU 嵌入式内核开发与移植，硬件模块驱动设计和开发，上层应用编写和维护等工作。

任职要求：



1. 计算机/电子工程/通信/自动化相关专业，硕士以上学历
2. 具备扎实的计算机软件基础，精通 C/C++ 程序设计，有 Cortex-M3 项目经验优先
3. 熟悉 ARM 体系架构，嵌入式操作系统开发环境及流程
4. 在校期间具备嵌入式项目应用软件开发经验者优先
5. 有 Windows 驱动或应用程序开发项目经验优先
6. 诚信正直，踏实努力，具有较强的抗压能力
7. 具有良好的沟通能力、学习能力、分析能力和团队合作能力

7、系统开发工程师（工作地：合肥）

岗位职责：

1. 基于公司 MCU 芯片方案的研发和维护
2. MCU 固件、应用程序编写
3. MCU 性能、功能测试，以及接口电路设计、调试
4. 编写 MCU 技术文档
5. 客户应用方案的审阅与除错支持

任职要求：

1. 本科及以上学历，电子类相关专业
2. 熟悉电路设计及调试
3. 熟悉 C 语言，有较好的编程习惯
4. 具备嵌入式芯片如 51 单片机、ARM 等系统设计项目经验
5. 诚信正直，踏实努力，具有较强的团队合作意识和抗压能力

8、FAE 技术支持工程师（工作地：深圳/合肥）

岗位职责：

负责 MCU 方面的技术支持，包括：

1. 协助 Sales 前期产品推广阶段的技术支持
2. 处理客户研发和生产阶段的技术问题，如：软硬件修改测试，产线异常处理等
3. 与质量部门、研发部门一起处理客户端 RMA

任职要求：

1. 电子/通讯/自动化等相关专业，本科及以上学历
2. 熟悉 Cortex M3 系列 MCU
3. 有 MCU 系统方面软硬件设计的项目经验优先



4. 良好的沟通交流能力、团队合作能力，善于处理客户抱怨
5. 能适应短期出差

9、IC 测试工程师（工作地：合肥）

岗位职责：

1. 新产品功能验证性测试开发，参数特性测试开发
2. 测试设备和制具开发、使用维护
3. 产品测试良率异常分析，不良品分析，电性失效分析，失效模式研究
4. 量产测试（CP&FT）流程和测试程式建立、完善与维护

任职要求：

1. 测控/自动化/计算机/通信/微电子等相关专业，本科及硕士学历，参加过电子类竞赛者优先
2. 熟悉 C、C++ 等高级编程语言
3. 熟悉常用测试设备使用方法及原理
4. 具有板级电路系统设计经验者优先
5. 了解 IC 制造生产流程优先

10、器件工程师（工作地：北京）

岗位职责：

负责 NAND Flash 产品的可靠性评估、参数调试和器件测试，与工艺、测试、设计部门合作，改善产品可靠性、品质和良率

任职要求：

1. 微电子及相关专业硕士及以上学历，博士优先
2. 具有扎实的电路以及半导体器件与物理基础
3. 了解电路设计，熟悉 C/perl/python 等编程语言，具有较强的动手能力和思考能力
4. 具有可靠性或工艺方面经验者优先

11、嵌入式软件（Firmware）工程师（工作地：合肥）

岗位职责：

1. 基于闪存介质的存储芯片及存储系统开发，例如：SSD, eMMC, UFS, 全闪阵列等。
2. 专注于 EMMC/UFS/NVMe/SCSI 等块设备接口协议实现
3. 专注于 Mapping, Garbage Collection, Wear leveling 等闪存管理算法与实现
4. 基于多核处理器的 Firmware 软硬件架构设计及实现
5. NAND flash 阵列仿真系统开发与实现

任职要求:

1. 计算机、电子等相关专业，硕士学历（优秀本科毕业生择优考虑）
2. 有嵌入式系统软件开发与调试经验
3. 熟悉文件系统者优先，熟悉 SPI / I2C / UART 等接口协议，有 PCIe /SATA/eMMC/NVMe 经验者优先
4. 了解 NAND 特性及 FTL 算法者优先
5. 具有较强的学习能力、沟通能力及自我管理能力

12、嵌入式系统工程师（工作地：合肥）

岗位职责:

1. 负责 Linux / Android 下嵌入式软件开发
2. 负责存储设备验证平台的设计与开发
3. 基于 GUI 或脚本的系统测试工具开发
4. 系统测试用例的设计及实现

任职要求:

1. 计算机、电子、自动化等相关专业，硕士学历（优秀本科毕业生择优考虑）
2. 精通 C/C++，有嵌入式软件及硬件驱动程序的开发经验
3. 有 Linux/Android 系统下块设备驱动程序开发经验者优先
4. 了解块设备协议，如 SATA/eMMC/SD/NVMe 者优先，熟悉 NAND 特性及管理算法者优先，具备 Python 开发能力者优先

13、射频集成电路设计工程师（工作地：北京/西安/苏州）

岗位职责:

负责射频模拟电路的设计和仿真

任职资格:

- 1、通信、微电子、微波及相关专业，硕士及以上学历
- 2、具有较好的 RFIC 设计、模拟 IC 设计基础，熟悉半导体器件、半导体物理的理论，熟悉 IC 设计流程和后端 Layout 设计流程
- 3、具有较强的学习能力、分析能力、沟通能力和较好的团队合作精神
- 4、良好的英语能力
- 5、有 LNA、Mixer、PA、PLL 等 IC 设计成功流片经验者优先
- 6、了解蓝牙/WIFI 协议者优先

14、产品工程师（工作地：合肥）



岗位职责：

负责 Flash 产品开发，以及产品管理工作

1. 新产品功能验证，参数特性测试验证
2. 产品的可靠性评估
3. 量产维护，不良品电性分析与良率改善
4. 收集市场需求，与测试、运营、设计部门沟通协调，准备及发放样品
5. 客户产品技术问题的支持

任职要求：

1. 电子类等相关专业，本科及硕士学历，微电子类专业优先
2. 熟悉常用测试设备使用方法及原理
3. 具有良好的沟通能力
4. 了解存储器的基本原理
5. 了解 IC 制造生产流程优先

15、无线网络物理层工程师（工作地点：苏州）

岗位职责：

1. WiFi 及其他无线通信协议的 PHY 层相关算法的设计、评估和优化
2. 链路级仿真平台的搭建和维护
3. 支持 ASIC/FPGA 验证，参与通信系统的联调和问题分析

任职要求：

1. 通信、电子等相关专业硕士
2. 熟悉无线通信与信号处理基本原理
3. 熟悉并了解通信系统算法开发的流程。
4. 以下为加分项：
 - 1) 具备通信系统物理层算法设计及仿真的经验
 - 2) 具备通信系统验证和联合调试的经验
 - 3) 熟悉 WiFi 协议
 - 4) 熟悉 ASIC 实现

★ 网申地址：job.gigadevice.com（参加宣讲笔试环节请携带一份纸质简历）

★ 每位应聘者只能投递投递 1 个职位哦~